

大连百傲化学股份有限公司

关于与苏州芯慧联半导体科技有限公司签署

《半导体设备业务合作结算协议》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

● 大连百傲化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月7日与苏州芯慧联半导体科技有限公司（以下简称“芯慧联”）签署了《半导体设备业务合作协议》，双方约定在半导体设备业务方面开展合作。截至本公告日，公司控制芯慧联54.6342%股权的表决权，已将芯慧联纳入合并报表范围，公司已无需再通过业务合作方式与芯慧联开展半导体设备相关业务，故公司与芯慧联签署了《半导体设备业务合作结算协议》，就半导体设备业务合作事项进行提前结算。截至本公告日，公司已收到芯慧联支付的业务合作结算款合计人民币156,025,097.18元。

- 本次交易不构成关联交易。
- 本次交易不构成重大资产重组。
- 本次交易已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，无需提交股东大会批准。

● 本业务合作结算协议已对收益分配结算方案、结算款金额计算、违约责任等内容做出了明确约定。本交易产生的应分配收益对公司财务报表的影响以公司聘请的审计机构的审计结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次交易情况概述

（一）本次交易的背景

2024年1月31日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关

于拟签署半导体设备业务合作协议的议案》，2024年2月7日，公司与芯慧联签署了《半导体设备业务合作协议》，公司委托芯慧联以自有资金购买半导体设备，合作款合计不超过人民币14,000.00万元，本次合作产生的利润按协议约定的方式进行分成。具体内容详见公司于2024年2月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《大连百傲化学股份有限公司关于与苏州芯慧联半导体科技有限公司拟签订〈半导体设备业务合作协议〉的公告》（公告编号：2024-006）。

2024年9月30日和2024年11月14日，公司分别召开第五届董事会第五次会议和2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于子公司拟对外投资暨增资并控股苏州芯慧联半导体科技有限公司的议案》，公司全资子公司上海芯傲华科技有限公司（以下简称“芯傲华”）拟通过增资并接受表决权委托方式合计控制芯慧联54.6342%股权的表决权。具体内容详见公司于2024年10月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《大连百傲化学股份有限公司关于子公司拟对外投资暨增资并控股苏州芯慧联半导体科技有限公司的公告》（公告编号：2024-051）。

2024年12月18日，公司获悉芯慧联已办理完成相关工商变更登记手续，并取得由常熟市数据局换发的营业执照。本次变更完成后，芯慧联的注册资本由7,000万元增加至13,125万元，芯傲华认购注册资本6,125万元，占比46.6667%，并通过接受表决权委托方式控制芯慧联7.9675%股权的表决权，合计控制芯慧联54.6342%股权的表决权，成为其控股股东，芯慧联纳入公司合并报表范围。

（二）本次交易履行的审议程序和主要内容

2024年12月23日，公司召开第五届董事会第九次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟签署半导体设备业务合作结算协议的议案》，因芯慧联已纳入公司合并报表范围，公司已无需再通过业务合作方式与芯慧联开展半导体设备相关业务，故公司拟与芯慧联签署《半导体设备业务合作结算协议》，经双方协商一致，就半导体设备业务合作事项进行提前结算。根据签署的《半导体设备业务合作结算协议》结算方案，公司应从芯慧联收取的业务合作结算款金额为156,025,097.18元。

根据《公司章程》的相关规定，本次交易无需经过股东大会审议。

(三) 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、对公司的影响

经公司初步测算，本次交易完成后公司将获得一定金额的应分配收益，预计将对履约当年度公司的净利润产生一定正面影响。公司将按照企业会计准则的相关要求进行会计处理，对公司财务报表的影响以公司聘请的审计机构的审计结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

三、其他说明事项

截至本公告日，公司已与芯慧联签署《半导体设备业务合作结算协议》，并已收到芯慧联支付的业务合作结算款合计人民币 156,025,097.18 元。公司与芯慧联签署的《半导体设备业务合作协议》结算完毕，双方关于半导体设备业务合作关系终止。

特此公告。

大连百傲化学股份有限公司董事会

2024 年 12 月 25 日